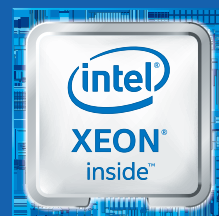


2CPU(最大44コア)のXeon® E5-2600 v4搭載。最大10基のPCI-E(x8)の拡張性

# HMV-S612DRX-R4



- インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v4製品ファミリーを搭載
- デュアルプロセッサーで、最大44コア (88スレッド)構成
- 最大2TBメモリー (DDR4)搭載可能
- サーバー/ワークステーション/組込み向けチップセット インテル® C612を装備
- 最大10基のPCI-E (x8)シグナルが使用可能
- 絶縁型32 DIO (16 DI/ 16 DO)を標準搭載
- リモート監視を実現するIPMI2.0装備
- オプションユニットの追加で、ミドルタワーとしても設置可能



## ■製品特長

### デュアルXeon® プロセッサ E5-2600 v4ファミリーとC612チップセット

画像処理・マシンビジョン分野において処理性能を向上させる14nmプロセス世代のCPU、インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 v4製品ファミリーを搭載。デュアルプロセッサ構成により最大44コア (88スレッド、Embedded選択時は36コア72スレッド)、最大2TBメモリー (DDR4)まで搭載可能です。またインテル® C612は、サーバーやワークステーション用途だけでなく、組み込み向け用途にも対応しているチップセットで長期供給が可能です。

### 最大10基のPCI-E(x8)スロット×デュアルプロセッサ

4UラックマウントシャーシにPCI Express x8シグナルのスロットを最大10基 (※標準: グラフィックスボードを1基搭載しているため、空きスロットは9基) 使用できる優れた拡張性。画像処理・マシンビジョン分野で利用されるフレームグラバードを多数搭載することが可能です。今まで産業用PC (シングルプロセッサ搭載時) 2台で運用してきたのを1台にまとめて効率化を図ることが可能です。

### 遠隔地からのリモート監視・制御を可能にするIPMIを搭載

ネットワークを通じて、遠隔地からPCの温度・電源・ファンの状態などを監視・制御することができます。

### 動作検証済みのDIOボードを標準搭載

動作検証済みのDIO (デジタル入出力) ボードを標準搭載。手間のかかる動作検証や不具合を気にすることなく、安心してDIOボードを搭載した産業用PCをお使いいただけます。

## ■製品仕様

プロセッサ	種類	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 v4
	搭載数	2
チップセット		インテル® C612 チップセット
メモリー	規格	DDR4 2400/2133/1866/1600MHz
	最大容量	2TB
	スロット数	16
ストレージ	5インチベイ	3
	3.5インチベイ	5 (空き3) ※標準: ストレージ (リムーバブル) ×2 使用
	スリムドライブベイ	1 (空き0) ※標準: ODD ×1 使用
	SATAコネクタ数	10 (空き7) (SATA 3.0) ※標準: ODD ×1 とストレージ (リムーバブル) ×2 使用
グラフィックス		NVIDIA® Quadro® K420 ASPEED AST2400 BMC
I/O	VGA	1 ※グラフィックスカード搭載およびオンボードRAID使用時、オンボードD-SUB端子からの出力ができません。
	シリアル (COM)	前面 1, 背面 1
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.0), 2 (USB2.0)
	LAN	2 (GbE)
	IPMI	1
	UID	1
	DIO	絶縁型DIO (16 DI, 16 DO) ※拡張ボードにより増設
拡張スロット	PCI Express x8	10 (x8シグナルGen 3.0、うち8基はオープンエンド) (空き9) ※標準: オープンエンドにQuadro® K420 ×1 搭載 1 (x4シグナルGen 2.0) (空き0) ※標準: DIO拡張ボード ×1 搭載
外形寸法		W437mm × D525mm × H178mm (突起物等を除く)
重量		約17kg
電源		1200W (600W×2, 80PLUS PLATINUM認証取得)
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10℃~35℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部  
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階  
TEL: 03-5446-5535 / hpcs\_sales@hpc.co.jp

[embe.hpc.co.jp](http://embe.hpc.co.jp)

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。  
2018年6月12日現在の内容です。